



新聞稿

No: 1131111

矽格中興三廠興建動土儀式

2024年11月11日(新竹) IC封測業股票上市矽格公司(6257) 11月11日於新竹縣竹東鎮中興路舉行中興三廠興建動土儀式，本次新建廠房工程包含土木及機電，估計投入新台幣26億，將興建地下兩層，地上七層，總樓板面積達36,340平方公尺的高科技廠房，預計在2027年第一季完工。將整合3A: 先進測試技術(Advance test technology)、自動化(Automation)、AI智慧工廠(AI factory)，瞄準AI、ASIC、Automotive 客群，預計工廠完工運轉後將提供約1,200新人的工作機會。

據矽格公司表示，最近國際政經環境大變化所帶來的衝擊與挑戰，未來諸多行業恐將面對更多的不確定性。然而半導體已經是全球戰略資源，只要未來幾年能帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的需求，矽格也會努力整合3A科技來抓緊商機。除了廠房硬體建設之外，同步運用3A新科技，精益求精、加強研發、工程、製造、品質等能力；將矽格的強項與這些重大的軟體投資結合，進而轉換成強大的接單能力來爭取客戶訂單。

新聞連絡人：陳祺昌先生

電話：03-5959213 分機 1514

傳真：03-5944495

E-mail：peter_chen@sigurd.com.tw